

KOSDAQ | 반도체와반도체장비
케이엔제이 (272110)
SiC Ring 애프터마켓 성장

체크포인트

- After Market 제품은 Before Market 제품보다 가격이 낮아 반도체 제조사 입장에서는 비용 절감을 위한 수단으로 사용. 동사는 A/M에서 약 50% 점유율을 확보. 주요 수요처인 NAND는 감산과 동시에 비용 절감이 지속적으로 이어지며 After Market 제품의 침투율이 증가 중
- SiC Ring 수요 측면에서, DRAM의 신규 CAPA 증설 효과와 NAND의 고단화 효과를 기대. NAND V10 부터 적용될 극저온 식각 장비는 Si Cover Ring-Sic Focus Ring 세트를 표준 옵션으로 채택하고 있어 SiC Focus Ring의 추가적인 침투율 확대를 예상
- 2025년 매출액 802억 원(+29.0% YoY), 영업이익 220억 원(+55.5% YoY)을 전망. 수익성 측면에서는 매출액 규모 확대, 제품 믹스 개선 등에 따라 전년 대비 4.7%p 개선된 영업이익률 27.4%를 전망

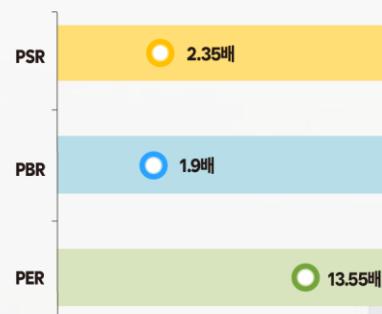
주가 및 주요이벤트



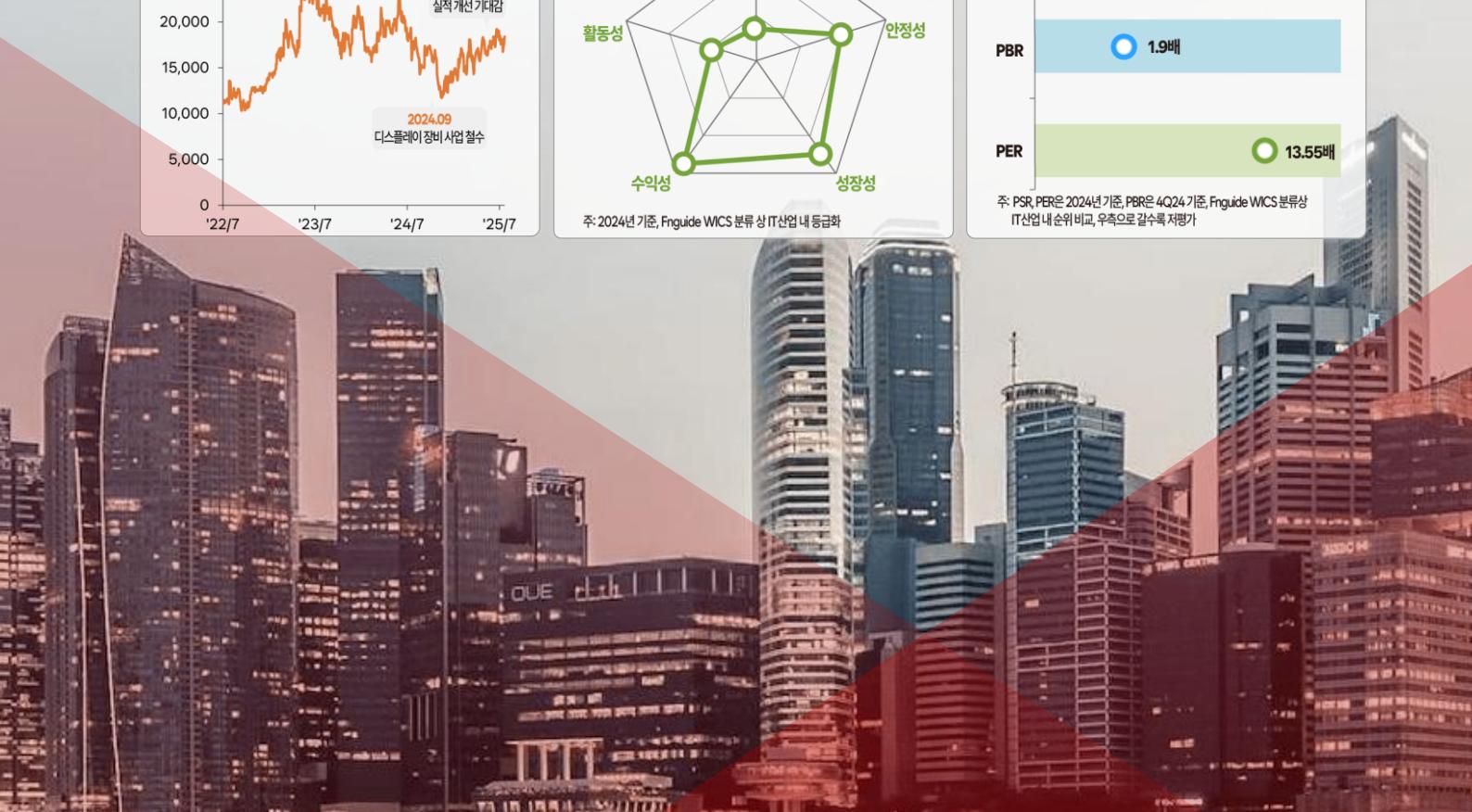
재무지표



밸류에이션 지표



주: PSR, PER은 2024년 기준, PBR은 4Q24 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 등급화



케이엔제이 (272110)

KOSDAQ

Analyst 박성순 sspark@kirs.or.kr

RA 김혜빈 hbkim@kirs.or.kr

반도체와반도체장비

SiC Ring 제조 업체

케이엔제이는 2005년 설립되어 2019년 코스닥 시장에 상장한 반도체 부품 업체. SiC Ring은 2024년 기준 전사 매출의 98.1%를 차지하며 주요 고객사로는 삼성전자, SK하이닉스 등이 있음

NAND 고단화와 CAPA 증설 효과 기대

After Market 제품은 Before Market 제품보다 가격이 낮아 반도체 제조사 입장에서는 비용 절감을 위한 수단으로 사용. 동사는 A/M에서 약 50% 점유율을 확보한 것으로 파악. 지속적인 수요 증가에 대응하기 위해 매년 증착 설비 라인의 증설을 진행하며 기존 CAPA의 약 80% 수준 증가 예상. SiC Focus Ring의 수요는 반도체 업체의 가동률, 신규 CAPA 증설, 그리고 3D NAND 고단화 등의 영향을 받음. NAND는 감산을 진행하는 가운데 고단화로의 전환 투자 중. DRAM은 선단 공정 중심 투자 집행. 따라서 수요 측면에서는 DRAM은 신규 CAPA 증설 효과와 NAND의 고단화 효과가 기대

After Market 침투율 확대

2025년 매출액 802억 원(+29.0% YoY), 영업이익 220억 원(+55.5% YoY)을 전망. DRAM은 HBM 수요 대응을 위한 선단 공정 투자가 이어지고 있으나 NAND는 감산을 통한 수급 조절 중. 다만 NAND 감산과 동시에 비용 절감이 지속적으로 이어지며 After Market 제품의 침투율이 증가하고 있다는 점은 긍정적. 또한, 하반기에는 일부 가동률 회복 가능성 있어 부품 수요 증가로 이어질 것으로 기대. 수익성 측면에서는 매출액 규모 확대, 제품 믹스 개선 등에 따라 전년 대비 4.7%p 개선된 영업이익률 27.4%를 전망

Forecast earnings & Valuation

	2021	2022	2023	2024	2025F
매출액(억원)	465	623	474	622	802
YoY(%)	9.2	34.0	-24.0	31.4	29.0
영업이익(억원)	44	133	105	141	220
OP 마진(%)	9.4	21.3	22.1	22.7	27.4
지배주주순이익(억원)	55	100	108	108	141
EPS(원)	771	1,255	1,354	1,349	1,755
YoY(%)	흑전	62.7	7.9	-0.4	30.1
PER(배)	22.2	10.2	14.3	10.0	10.7
PSR(배)	2.6	1.6	3.2	1.7	1.9
EV/EBITDA(배)	25.5	8.0	11.8	7.8	6.0
PBR(배)	3.1	1.9	2.4	1.5	1.8
ROE(%)	16.8	20.4	18.1	15.8	18.0
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

Company Data

현재주가 (8/13)	18820원
52주 최고가	19,180원
52주 최저가	11,720원
KOSDAQ (8/13)	814.10p
자본금	40억원
시가총액	1,510억원
액면가	500원
발행주식수	8백만주
일평균 거래량 (60일)	6만주
일평균 거래액 (60일)	10억원
외국인지분율	61.8%
주요주주	심호섭 외 3 인 에셋플러스자산운용
	24.27% 504%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	2.4	14.3	5.3
상대주가	0.7	5.2	-1.1

참고

1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '이자보상비율', 성장성 지표는 '매출액 증가율', 수익성 지표는 'ROE', 활동성지표는 '총자산회전율', 유동성지표는 '유동비율'임. 2) 표지 벌류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 벌류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 벌류에이션 매력도 높음.



기업 개요

1 케이엔제이는 반도체 부품 전문 기업

케이엔제이는 2005년 설립되어

2019년 상장한

반도체 부품 전문 기업

케이엔제이는 2005년 4월 디스플레이 패널용 장비 제조를 목적으로 설립되어, 삼성전자에 LCD 장비를 공급하며 성장했다. 주력 제품은 유리 원장 절단용 엣지 그라인더와 표면 손상 검사 장비(AOI)로, 삼성디스플레이(SDC)와 중국 패널 업체 등 국내외 주요 디스플레이 제조사를 고객사로 확보했다. 2010년에는 삼성전자 LED 생산 라인에 SiC 서셉터를 납품하며 사업 영역을 확장했다. 그러나 중국산 저가 제품과의 가격 경쟁이 심화되면서 LED용 SiC 사업은 2010년 대 중반부터 2020년대 중반까지 장기간 적자를 기록했다. 이후 동사는 축적된 SiC 제조 기술을 바탕으로 세계에서 두 번째로 반도체 식각 공정용 SiC 포커스링 개발에 성공했고, 2016년 SK하이닉스에 처음으로 양산 공급을 시작했다. SiC 포커스링은 식각 장비 내 플라즈마를 균일하게 유지해 공정 효율과 수율을 높이는 핵심 소모품으로, 기존 실리콘 소재 대비 내구성이 뛰어나 높은 단가에도 불구하고 수요가 꾸준히 증가하고 있다.

2019년에는 SK하이닉스에 이어 삼성전자의 SiC 포커스링 공급업체로도 등록되었다. 같은 해 10월 25일, 코스닥에 상장하여 연구개발과 생산능력 확대를 위한 자본 기반을 강화했다. 상장 이후 2020년부터는 SiC Ring 공급량이 크게 확대되어 디스플레이 장비 부문의 부진에도 불구하고 반도체 SiC 부품 부문이 전사 실적 성장을 견인했다. 2021년에는 충남 아산시에 신규 사업장을 신축하고 본사도 현재의 아산시 읍봉면으로 이전한 후, 2022년 추가적인 증설을 통해 반도체 업황 회복과 시장 수요 증가에 대응하였다.

2024년 9월에는 디스플레이 제조용 장비 사업(엣지 그라인더 및 검사장비)에서 전면 철수하기로 결정하고 현재까지 반도체 SiC 부품 등 핵심 사업에 역량을 집중하고 있다. 현재 보유한 CVD 챔버는 총 13대로, 이는 연간 매출 환산 시 약 1,000억 원 규모에 해당한다. 동사는 아산 사업장 내에 CVD 챔버 20대 이상을 설치할 수 있는 부지를 확보했으며, 현재 증설 작업을 진행 중이다. 매년 2~4대의 신규 챔버를 추가하는 것을 목표로 하고 있으며, 올해 연말까지 총 10대의 추가 챔버 증설을 완료하여 증가하는 수요에 대응할 계획이다.

케이엔제이 연혁

2005~2009	2010~2018	2019~
2005.06 주식회사 케이엔에이 설립	2010.04 본점이전(충남아산시음봉면)	2019.10 코스닥시장상장
2006.03 기업부설연구소(충남부사기술진흥협회)	2011.11 취(OEMS) 인수합병	2021.04 글로벌강사기업신사업(충남중소벤처기업청)
2006.05 벤처기업인증(기술보증기금)	2012.09 본점이전(충남아산시단양포면)	2021.06 뿌리기인증(국가기록관리인증진흥센터)
2007.11 제37회 한국창업만족기술상 산업지원부 장관상 수상(개인단체)	2014.03 중국법인설립(쑤저우)	2021.11 본점이전(충남아산시음봉면)
2008.03 대표이사변경(삼현대표이사취임)	2014.12 제51회무역인상『전천민불수출의집』 수상(한국무역협회)	2022.09 ISO 14001 인증(전국인증특수)
2008.06 기술혁신형중소기업(INNO-BIZ) 인증(중소기업청)	2016.12 제53회무역인상『3천만불수출의집』 수상(한국무역협회)	2023.04 기술혁신수상기업총람도지사표창
2009.12 기술선행창업기업 선정(중소기업청)		2023.05 동읍산단창업장증정
		2023.10 충청남도 우망중소기업선정
		2025.02 성과공유기업 지정(충남중소벤처기업부)

자료: 케이엔제이, 한국IR협의회 기업리서치센터

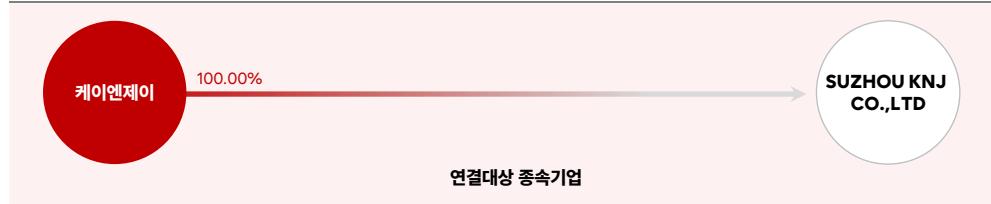
2 종속회사 현황

케이엔제이의 연결대상

종속회사는 1Q25말 기준 1개사

케이엔제이의 연결대상 종속회사는 2025년 1분기말 기준 1개사로, 중국 장쑤성 쑤저우시에 위치한 SUZHOU KNJ CO., LTD.(지분율 100%)이다. 2014년 설립된 SUZHOU KNJ CO., LTD.(지분율 100%)는 케이엔제이가 2024년 9월까지 영위했던 디스플레이 사업에 대한 A/S를 위해 유지하고 있다. 2024년 말 기준 자산총계는 약 15억 원이다.

케이엔제이 지분도



3 주요 사업 및 매출 구성

SiC Ring은 2024년 기준

전사 매출액 98.1% 차지

동사는 SiC Ring을 주력으로 생산하고 있으며 SiC Ring은 2024년 기준 전사 매출액의 98.1%를 차지하였다. 주요 고객사로는 삼성전자, SK하이닉스 등이 있다. SiC Ring은 반도체 식각 공정에서 사용되는 핵심 소모품으로 동사는 특히 CVD(Chemical Vapor Deposition) 공법으로 제조된 SiC Focus Ring이 주력 제품이다. 이는 기존 실리콘(Si) 소재의 한계를 극복하기 위해 개발된 차세대 소재로 고온, 고압의 플라즈마 환경에서도 우수한 내구성과 화학적 안정성을 제공한다.

케이엔제이 주요 제품

반도체 / LED 공정용 부품사업

- CVD SiC 증착 기술을 활용한 반도체 및 LED 공정용 핵심 부품의 생산 및 공급
- CVD SiC는 화학기상증착 (CVD, Chemical Vapor Deposition) 공법을 사용하여 SiC를 증착시키는 기술을 기반으로 박막층에서 수mm 이상의 두꺼운 Bulk 형태까지 증착 가능하며, 업계 최고 수준의 안정적인 대량 생산 공정 기술 확보



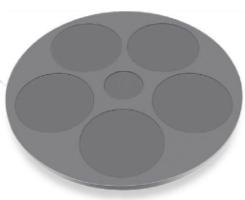
Bulk CVD SiC 제품

- 용도** 반도체 제조공정 중 예칭공정에 사용되는 부품
특징 내구성이 뛰어나 공정 수율을 높이는데 기여함



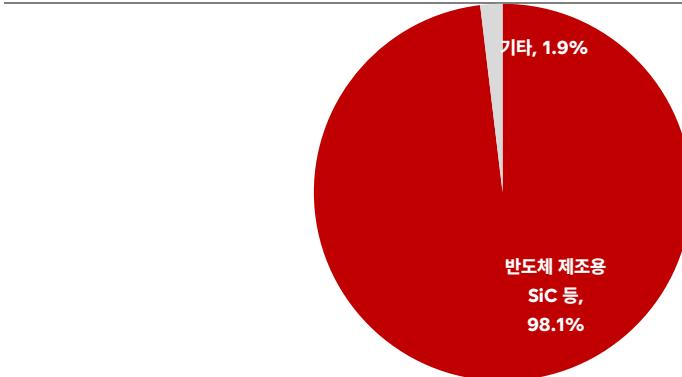
CVD SiC 박막 코팅 제품

- 용도** 반도체 및 LED 제조공정에 사용되는 Wafer 처리용 소모성 부재로 사용
특징 원소재 위에 얇은 SiC 박막을 형성하여 원소재의 Outgassing과 Particle 발생 억제함



자료: 케이엔제이, 한국IR협의회 기업리서치센터

케이엔제이 매출 비중



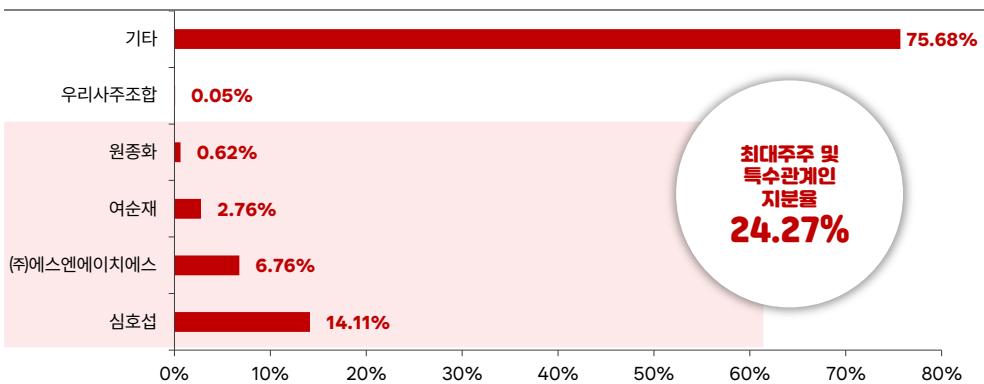
주: 2024년 기준, 자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

4 주주 구성

케이엔제이의 최대주주 및
특수관계인은 대표이사 심호섭 외
3인으로 지분율 24.27% 보유

케이엔제이의 최대주주는 대표이사 심호섭으로, 2025년 1분기 말 기준 지분 14.11%를 보유하고 있다. 심 대표는 서울대학교 기계공학과를 졸업한 뒤 2001년 소프트웨어 기업 올엔지를 창업해 장비 업체를 대상으로 비전 소프트웨어와 장비 제어 프로그램 등을 공급했다. 이 과정에서 케이엔제이 창립 멤버들과 인연을 맺었으며, 2005년 케이엔제이 설립 이후 약 2년간 올엔지가 동사의 소프트웨어 개발을 전담하며 협력 관계를 유지했다. 2007년 양사 통합을 추진해 2008년 주주총회 의결을 거쳐 심 대표가 동사의 대표이사로 취임했으며, 현재까지 경영을 이끌고 있다.

케이엔제이 주주 현황



주: 1Q25말 기준, 자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터



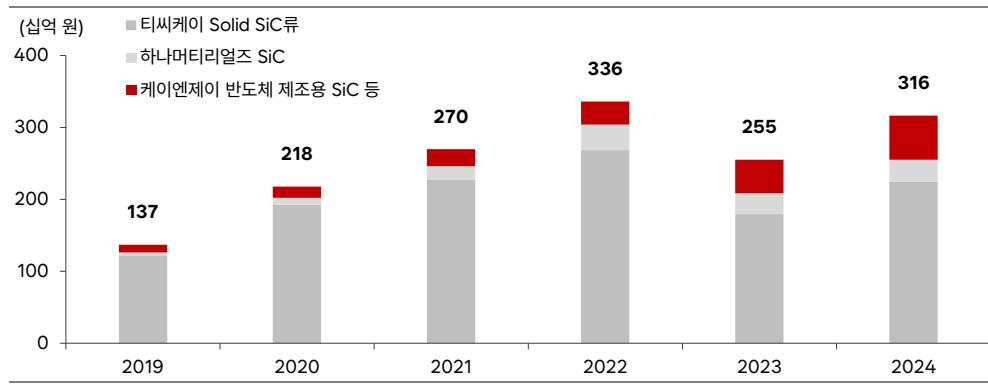
산업 현황

1 국내 SiC Ring 시장 규모

**국내 SiC Ring 시장은
2024년 기준 약 4,120억 원
추정. 티씨케이가 전체 시장의
50~60%, 케이엔제이는
애프터마켓에서 약 50% 점유율
차지하는 것으로 추정**

국내 SiC Ring 시장 규모는 2024년 기준 약 4,120억 원으로 추정된다. 티씨케이가 시장의 약 50~60%를 차지하며 높은 시장 지배력을 보이고 있으며, 동사는 약 15% 점유율을 차지한 것으로 파악된다. 다만 케이엔제이는 After Market에서는 약 50%의 시장 점유율을 차지하고 있다. 동사를 비롯한 상장사 티씨케이, 하나마트리얼즈 외 디에스 테크노, 와이컴은 비상장 업체로 구체적인 SiC Ring 제품 매출액을 파악하기 어렵다. 상장된 3사의 SiC Ring 부문 매출 추이를 보면 2019년 케이엔제이가 상장한 이후 지속적인 성장세를 보여왔으며 메모리 감산 규모가 컸던 2023년 만 전년 대비 24.1% 감소하였다. 2023년에도 Before Market 제품은 매출액 감소를 보인 반면 원가 절감 효과가 있는 After Market 제품은 오히려 매출액이 증가하였다.

국내 SiC Ring 매출액 추이



자료: 각 사, 한국IR협의회 기업리서치센터

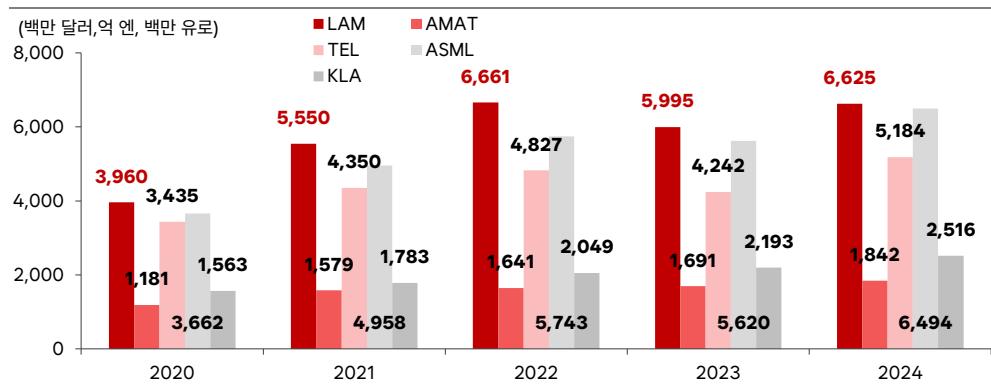
2 글로벌 반도체 부품 시장 규모

**글로벌 반도체 소모성 부품 시장은
2024년 전년 대비 성장**

글로벌 반도체 소모성 부품(Quartz, Ceramic, Si, Graphite, CMP 등) 시장 규모는 약 100억 달러로 추정된다. 시장 규모는 Parts 업체들의 매출과 장비 업체들의 유지보수 부문의 매출 등으로 매출 추이를 기نة해볼 수 있다. 반도체 소모성 Parts는 장비사를 통해 공급되는 Before Market과 반도체 제조업체로 직접 공급되는 After Market으로 구분된다. 일정 워런트 기간 동안 반도체 제조업체는 장비사를 통해 Parts를 구입하기 때문에 장비사의 유지보수 부문 매출에 Parts 매출이 포함되어 있다. 장비사의 유지보수 부문 매출에는 소모성 하드파츠(Quartz, Ceramic, SiC, Graphite 등), 업그레이드 키 및 중고 리퍼비시 장비, 현장 유지보수(Service Labor)를 모두 합친 매출이다.

Lam Research(미국), Applied Materials(미국), Tokyo Electron(일본), ASML(네덜란드), KLA(미국) 등 글로벌 Top 5 장비 업체의 유지보수 매출액은 2024년 기준 각각 LAM 66억 달러(+10.5% YoY), AMAT 18억 달러(+8.9% YoY), TEL 5,184억 엔(+22.2% YoY), ASML 65억 유로(+15.6% YoY), KLA 25억 달러(+14.7% YoY)를 기록하였다. 2023년 반도체 업황 둔화 이후 2024년 반도체 업체들의 가동률 회복으로 실적 성장세로 돌아섰다. 국내 주요 7개 Parts 업체들의 매출액 추이도 2023년 전년 대비 9.3% 감소한 이후 2024년 전년 대비 12.9% 성장을 기록하였다.

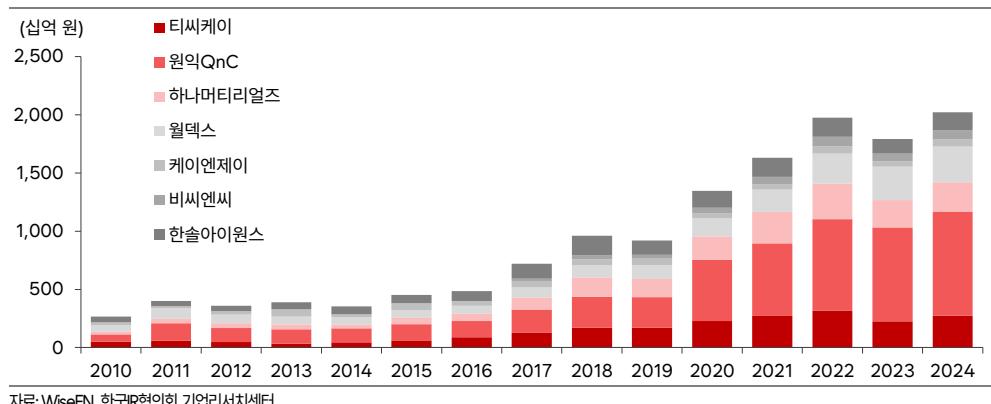
글로벌 장비 5사 유지보수 부문 연간 매출액 추이



주: Calendar Year 기준

자료: 각 사, 한국IR협의회 기업리서치센터

국내 반도체 Parts 업체 연간 매출액 추이



자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

3 글로벌 반도체 장비 시장 전망

AI·HBM 수요와 공정 난이도

증가로 부품 수요 확대

반도체 소모성 부품의 성장 요인은 장비 누적 설비 대수 증가, 공정 난이도 증가, 가동률 회복 등에 기인한다. HBM, GAA, NAND 고단화 등으로 인한 공정 난이도 증가는 파츠 수명 주기를 단축시켜 과거 대비 빠른 교체 주기를 유발한다. 가동률은 최근 AI, HBM 수요 확대로 상승하고 있어 파츠 수요에 긍정적이다. 이와 함께 장비의 설치 베이스 증가는 파츠 수요를 근본적으로 증가시키는 요소이다.

AI·메모리 투자 확대로

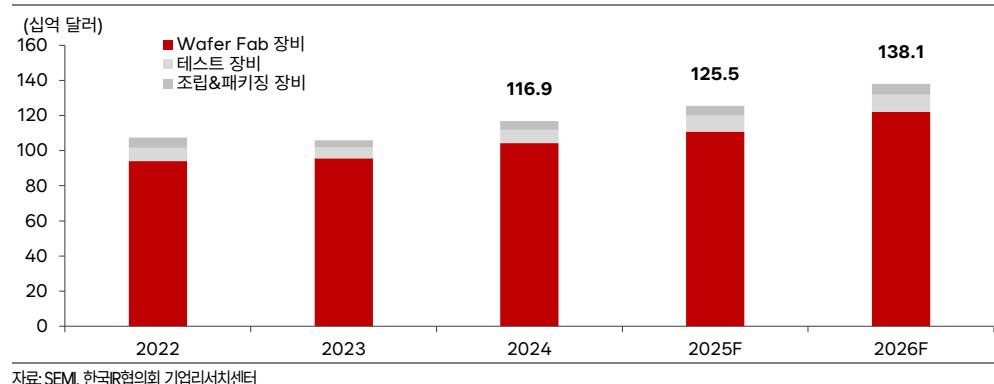
2025~26년 글로벌 장비 매출

사상 최대 전망

2025년 글로벌 반도체 장비 매출은 전년 대비 7.4% 증가한 1,225억 달러로 사상 최대치를 기록할 전망이다. 2026년에도, 최첨단 로직, 메모리 및 기술 전환에 힘입어 매출은 1,381억 달러까지 성장할 것으로 예상된다. 이 중 파츠 수요에 직접적 영향을 미치는 웨이퍼 처리, 패시설, 마스크/레티클 장비를 포함하는 웨이퍼 패 장비(WFE) 부문은 작년에 1,043억 달러라는 사상 최대 매출을 기록한 후, 2025년에는 전년 대비 6.2% 증가한 1,108억 달러에 이를 것으로 예상된다. 이는 주로 파운드리 및 메모리 애플리케이션 매출 증가에 기인한다. 2026년에는 WFE 부문 매출이 전년 대비 10.2% 증가한 1,221억 달러에 이를 것으로 전망된다. 이러한 성장의 주요 동인은 AI 애플리케이션을 지원하기 위한 최첨단 로직 및 메모리 분야의 생산 능력 확대와 주요 부문 전반에 걸친 지속적인 공정 기술 마이그레이션 등이다.

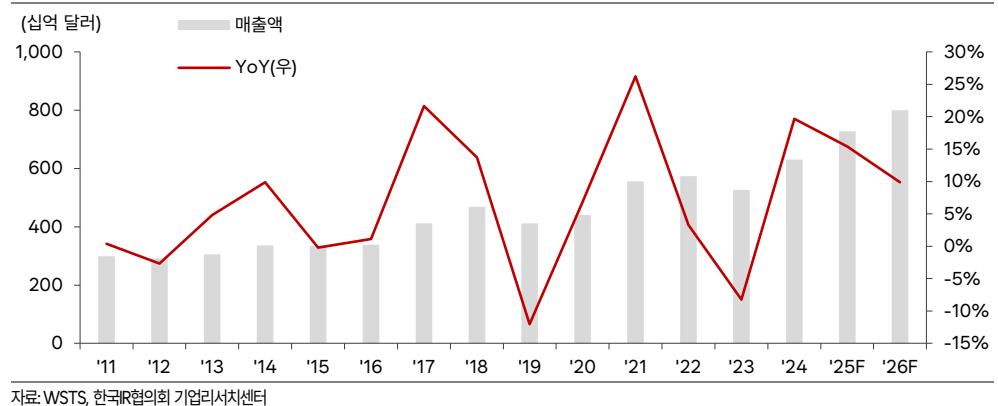
첨단 노드 HBM 투자로**WFE·메모리 장비 시장 성장 지속**

파운드리 및 로직 애플리케이션용 WFE 매출은 첨단 노드에 대한 강력한 수요에 힘입어 2025년 전년 대비 6.7%의 안정적인 성장을 기록하여 648억 달러에 이를 것으로 예상된다. 2026년에는 전년 대비 6.6% 성장하여 690억 달러에 이를 것으로 전망된다. 업계가 2nm GAA 노드의 대량 생산으로 전환함에 따라 생산 능력 확대 구매 증가와 최첨단 기술에 대한 수요 증가가 주요 성장 요인이다. 메모리 관련 자본 지출은 2025년에 증가하고 2026년에도 지속적인 성장을 보일 것으로 예상된다. NAND 장비 매출은 2023년의 급격한 위축에서 회복세를 보이고 있고 2024년 전년 대비 4.1%의 소폭 증가를 기록한 NAND 장비 시장은 3D NAND 적층 기술 발전 및 용량 확장에 따라 2025년 137억 달러(+42.5% YoY), 2026년에는 150억 달러(+9.7% YoY)에 이를 것으로 예상된다. 2024년 전년 대비 40.2% 급증한 195억 달러를 기록한 DRAM 장비 매출은 AI 구축을 위한 HBM 투자에 힘입어 2025년과 2026년에 각각 6.4%와 12.1% 성장할 것으로 보인다.

글로벌 반도체 장비 매출액 전망**4 글로벌 반도체 시장 전망****2025년 글로벌 반도체 시장은****7,280억 달러로 전년 대비****15.4% 성장할 것으로 전망**

글로벌 반도체 시장은 2024년 전년 대비 19.7%의 강한 성장에 이어 2025년 7,280억 달러로 전년 대비 15.4% 성장할 것으로 전망된다. 구체적으로 Logic 시장과 메모리 시장은 전년 대비 각각 29.0%, 17.1% 성장하며 전체 반도체 시장 성장을 견인할 것으로 예상된다. 두 부문 성장은 모두 AI, Cloud 인프라, 첨단 IT 제품 등에서의 지속적인 수요와 초기 AI 엣지 애플리케이션에 기인한다. 센서와 아날로그 부문은 완만하지만 성장세를 이어갈 것으로 보인다. 다만 Discrete(개별 반도체)은 전년대비 시장 규모가 축소될 것으로 예상되는데 이는 무역갈등, 공급망 차질, 특정 응용 분야의 수요 감소 때문이다. 2026년도 2025년과 같이 Logic, 메모리가 시장 성장을 견인하여 7,997억 달러(+9.9% YoY) 규모로 성장할 것으로 전망된다.

글로벌 반도체 시장 규모 추이 및 전망





투자포인트

1 After Market 침투율 증가 추세

SiC Focus Ring, 내구성·성능

강점. 반도체 식각 공정 별 요구

조건 및 파츠 가격 민감도 상이해

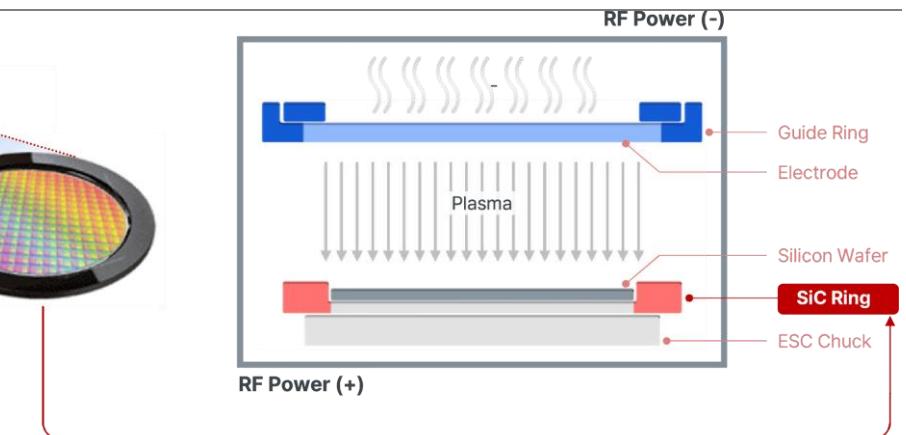
SiC Focus Ring 침투율은 현재

35% 정도에서 점진적 확대 전망

SiC Focus Ring의 After Market 확대에 따른 동사 공급 증가가 기대된다. Focus Ring은 식각 공정의 챔버 내에서 웨이퍼 가장자리를 둘러 쌓는 링 형태의 소모성 부품으로 웨이퍼를 고정하고 정전력을 보호함과 함께 플라즈마의 분포를 균일하게 하여 수율을 향상시키는 역할을 한다. Focus Ring 소재로는 주로 퀼츠, Si, SiC, Al_2O_3 등이 사용된다. 폴리(Poly)막에는 염소(Cl) 계열과 브롬(HBr) 계열의 가스가 주로 사용되어 이에 대한 내화학성이 우수하고 열적 안정성이 높은 퀼츠가 많이 사용된다. 산화막(SiO_2)과 질화막(Si_3N_4) 식각에는 플루오르 카본(C_2F_6) 계열 가스를 사용하고 Si 또는 SiC가 주로 사용된다. 메탈 레이어 중 Al에는 염소 계열 가스가 사용되고 Focus Ring으로는 Al_2O_3 이 많이 사용된다.

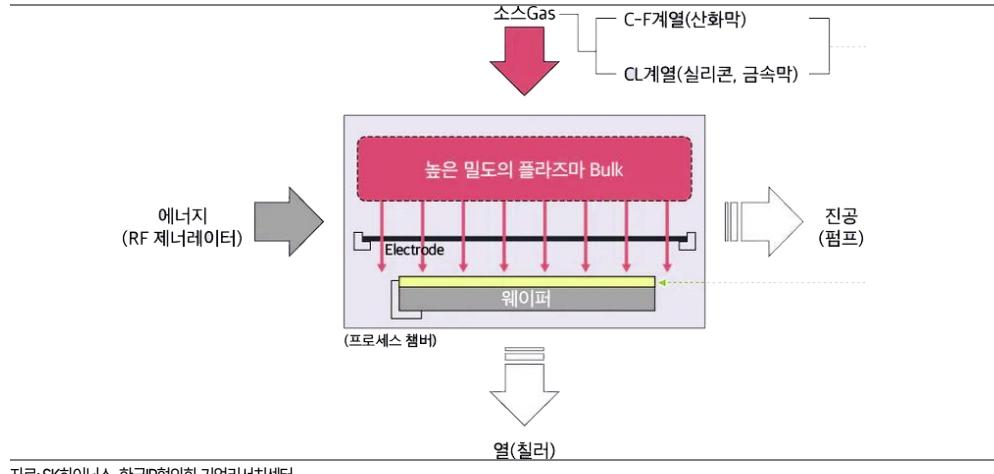
SiC Focus Ring은 산화막, 질화막 식각에 주로 사용되며 메탈 레이어에도 일부 사용된다. 특히 SiC는 우수한 열전도율, 내식각성 등의 장점을 바탕으로 Si를 대체하는 소재이다. 따라서 SiC Focus Ring의 교체 주기가 Si 대비 길다. SiC Focus Ring의 비용이 높더라도 장비 가동 중단 시간과 교체 비도가 줄어들어 총소유비용(TCO) 관점에서 분명한 이점이 발생한다. 또한 SiC는 파티클 발생률이 낮아 미세 패턴 훼손 위험이 낮은 것도 장점이다. ONO(Oxide-Nitride-Oxide) 구조를 가진 3D NAND의 산화막, 질화막 식각 공정이 DRAM 대비 많고 다층 구조로 강한 내플라즈마성을 보여야 함으로 NAND에서의 SiC Focus Ring에 대한 수요가 DRAM 대비 상대적으로 크다. 다만 향후에도 SiC가 모든 Si Focus Ring을 대체하지는 않을 것이다. 반도체 식각 공정마다 요구하는 조건이 다르고 이에 다른 Parts의 가격 민감도도 다르기 때문이다. 따라서 SiC Focus Ring의 침투율도 현재 약 35% 정도로 점진적으로 확대되고 있고 궁극적으로 약 50%까지 확대될 여력이 있다고 판단된다.

식각 챔버 구조와 Focus Ring



자료: 케이엔제이, 한국IR협의회 기업리서치센터

막질에 따른 플라즈마 소스가스



자료: SK하이닉스, 한국IR협의회 기업리서치센터

SiC Ring과 같은 반도체 부품 시장은 크게 유통망에 따라 Before Market과 After Market으로 구분된다. Before Market은 부품업체에서 장비 제조사를 통해 반도체 제조사로 공급되는 구조이며, After Market은 반도체 제조사와 장비사의 Warrant 기간 이후 반도체 제조사가 직접 부품 업체로 구매하는 구조이다. SiC Ring의 경우 Before Market에 서의 공급자는 티씨케이와 하나마티리얼즈가 있다. After Market에서는 동사를 비롯하여 디에스테크노, 와이컴 등이 있다. 동사는 2016년 SK하이닉스에 SiC Ring 공급을 시작으로 2020년 삼성전자로 공급을 확대하였다. After Market 제품은 Before Market 제품보다 가격이 낮아 반도체 제조사 입장에서는 비용 절감을 위한 수단으로 사용된다. Before Market 제품은 부품에 장비 업체의 마진이 더해지기 때문에 가격이 상대적으로 높을 수밖에 없다. SK하이닉스는 SiC Ring 사용량의 약 절반을 After Market 제품으로 사용하는 것으로 파악되며, 삼성전자는 상대적으로 낮은 것으로 보인다. 이는 삼성전자가 SK하이닉스 대비 늦게 After Market 제품을 적용하기 시작하였기 때문으로 판단된다. 향후 Warrant 기간 종료, 원가 절감 등을 위해 After Market 제품 비중이 추가적으로 확대될 여지가 있다고 판단되며 이에 따라 동사 SiC Focus Ring 공급 확대가 기대된다.

반도체 부품(SiC Ring) 시장 구분



자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

▣ 수요 대응을 위한 선제적 CAPA 증설

**자체 CVD 챔버 기술·일관된
생산체계 보유에 따른 품질 원가
경쟁력 확보가 차별화 요소**

케이엔제이의 핵심 경쟁력은 자체 개발한 CVD 증착 챔버 기술과 통합적 생산 체계에 있다. 대부분의 경쟁사들이 외부에서 증착 장비를 도입하는 것과 달리, 동사는 증착 챔버부터 후공정까지 일관된 생산 체계를 구축하고 있다. 이를 통해 공정 최적화와 품질 관리가 용이하며 고객 요구사항에 따른 맞춤형 제품 개발도 신속하게 대응할 수 있다. 또한 모재 가공 → 고순화 → SiC 증착 → 그래파이트 제거에 이르는 전체 공정을 자체적으로 보유하고 있어, 원가 경쟁력과 품질 안정성을 동시에 확보하고 있다. 동사는 CVD-SiC 증착 기술뿐만 아니라 CVD 증착 챔버를 자체 개발함으로써 생산 과정에서 발생할 수 있는 오류와 불량을 신속하게 해결할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있다. 이는 수율 향상과 직결되는 중요한 차별화 요소이다.

동사는 지속적인 수요 증가에 대응하기 위해 매년 증착 설비 라인의 증설을 진행하며, 최근에는 아산에 신규 건물을 증축 중이다. 2025년 말까지 건물 증축이 완료되고 순차적으로 증착 챔버 증설을 진행할 예정이다. 총 증설 규모는 기존 CAPA의 약 80% 수준으로 추정된다. 향후 시장 수요에 적기 대응이 가능하고 신규 고객 확보에도 용이할 것으로 판단된다.

케이엔제이 아산사업장



자료: 케이엔제이, 한국IR협의회 기업리서치센터

아산사업장 현황

- 2021년 신축 입주
- SiC Focus Ring 주력 생산기지
- 일관생산 체계, 가공 자동화시스템 구축 중
- 면적 : 17,461m² (5,300평 부지)

▣ DRAM 신규 CAPA, NAND 고단화는 SiC Ring 수요 증가 요소

**SiC Focus Ring 수요는
메모리 CAPA 증설 고단화 투자,
3D NAND 단수 증가에 따른
플라즈마 강도 상승 등으로 확대
전망**

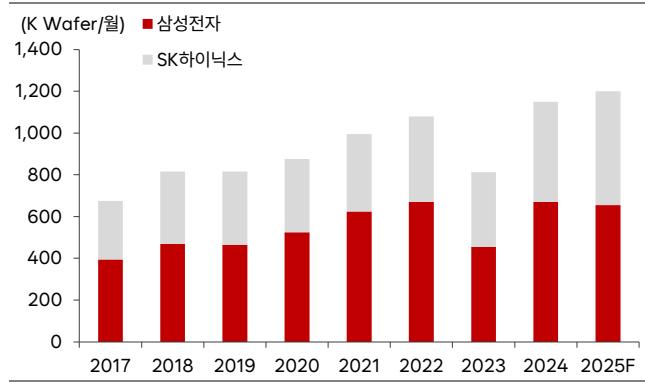
SiC Focus Ring의 수요는 반도체 업체의 가동률, 신규 CAPA 증설분, 그리고 3D NAND 고단화 등의 영향을 받는다. 특히 동사 매출의 100%가 메모리에서 창출되고 있는 만큼 메모리 업체의 가동률과 CAPA 증설이 파츠 수요에 절대적인 영향을 끼친다. DRAM은 2023년 감산 이후 2024년부터 가동률이 회복되었고, HBM 생산 확대와 이를 위한 선단공정 전환 중심의 투자가 지속되고 있다. 삼성전자의 P4와 SK하이닉스의 M14, M16 일부 라인 투자가 있고 연말에는 M15X가 계획되어 있다. NAND는 신규 CAPA 투자가 부재한 가운데 다시 가동률이 낮아진 상황이나 고단화 전환 투자를 진행 중이다. Kioxia는 Kitakami Fab2를 9월에 가동할 예정이다. 따라서 SiC Focus Ring 수요 측면에서는 DRAM은 신규 CAPA 증설 효과와 NAND의 고단화 효과가 기대된다.

3D NAND의 단수가 증가함에 따라 플라즈마 강도가 증가하고 이에 따라 SiC Focus Ring의 수요도 함께 증가하는 경향이 있다. 단수가 늘어남에 따라 식각해야 하는 층의 깊이와 폭이 증가하여 식각 공정에서 고종횡비(High-Aspect-Ratio) 구조를 형성해야 한다. 이와 같은 식각을 위해서는 플라즈마의 에너지와 밀도가 증가해야 한다. 하지만 강한 플라즈마는 Focus Ring을 포함한 소모성 부품의 마모와 부식을 촉진한다. 소모성 부품에서 파티클이 발생할 가능성이

높아지며 이는 공정 품질에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이러한 환경에서는 SiC Focus Ring이 높은 내식성, 내마모성, 열적 안정성을 제공하여 공정 품질 유지와 장비 효율성 향상에 크게 기여할 수 있다. 따라서 NAND 단수 증가에 따른 플라즈마 강도 증가로 SiC Focus Ring의 수요 증가로 이어진다.

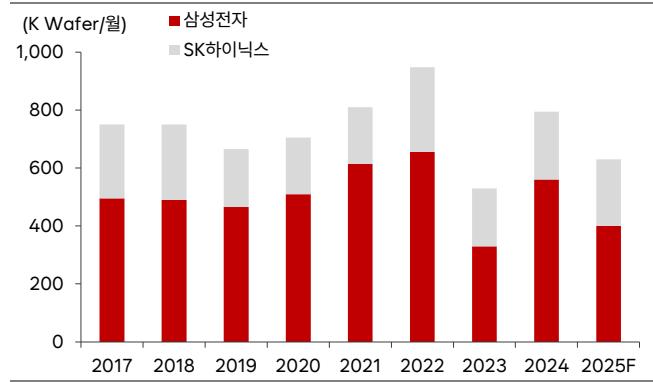
NAND 시장에서는 V7 등의 구형 NAND 제품이 중국 YMTC 등의 생산 확대와 IT 수요 부진으로 인해 공급 과잉을 보이고 있으며, 중국 외 공급사들은 레거시 제품 중심으로 감산을 진행하고 있다. 이에 따라, 삼성전자와 SK하이닉스는 V7(176단) 생산을 줄이고 V8(236단)과 V9(290단)으로의 전환 투자를 진행 중이다. 특히 삼성전자는 V6(128단) 주력이던 시안 Fab을 V8(236단) 전환하는 한편, 화성과 평택 일부 라인도 V8, V9(290단)로 전환하여 하반기까지 구축 할 계획이다. 이에 따라 4Q25에는 전체 NAND 시장에서 V8 이상이 차지하는 비율이 50%를 상회할 것으로 전망된다. 반도체 고객사들의 고단화 전환에 따라 동사의 부품 수요가 더욱 확대될 것으로 예상된다. V10 투자는 2026년 상반기로 예상된다. 특히 V10부터 적용될 극저온 식각 장비는 Si Cover Ring-SiC Focus Ring 세트를 표준 옵션으로 채택하고 있어 SiC Focus Ring의 추가적인 침투율 확대 요소가 될 것으로 기대된다.

국내 DRAM CAPA 전망



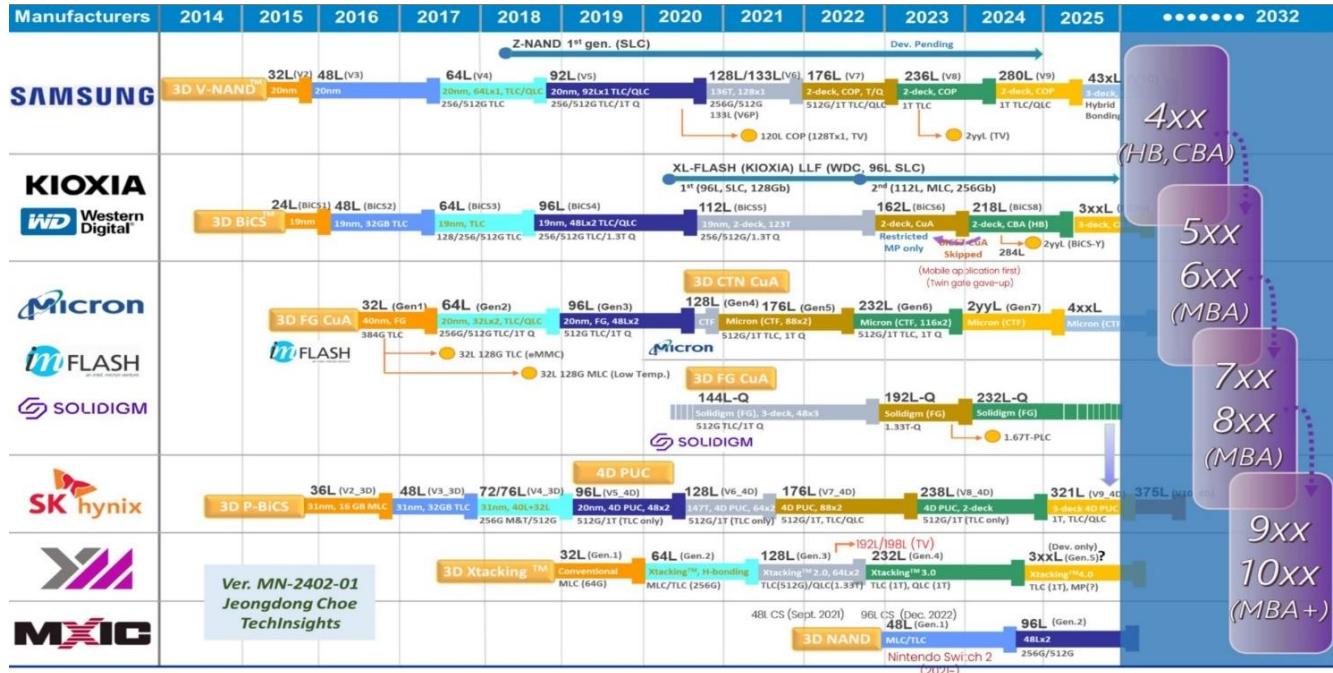
자료: 업계자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

국내 NAND CAPA 전망



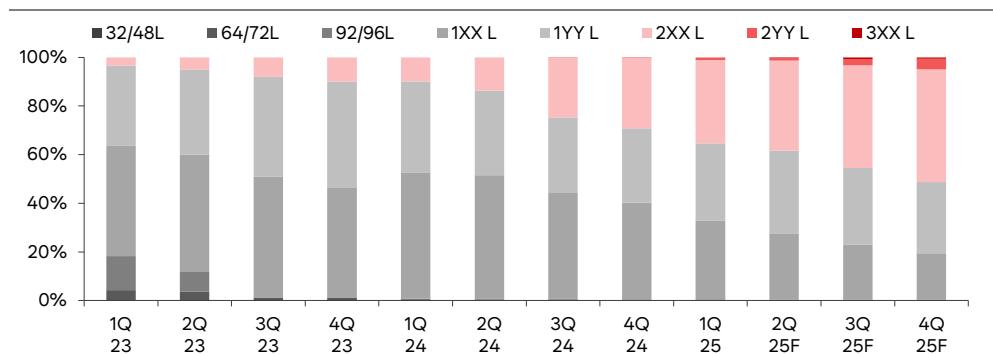
자료: 업계자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

NAND Tech Roadmap



자료: Tech Insight, 한국IR협의회 기업리서치센터

NAND 단수별 비중



주: 32/48L, 64/72L, 1XXL 등은 NAND의 적층 단수를 의미. 숫자가 증가할수록 고단화

자료: 업계자료, 한국IR협의회 기업리서치센터



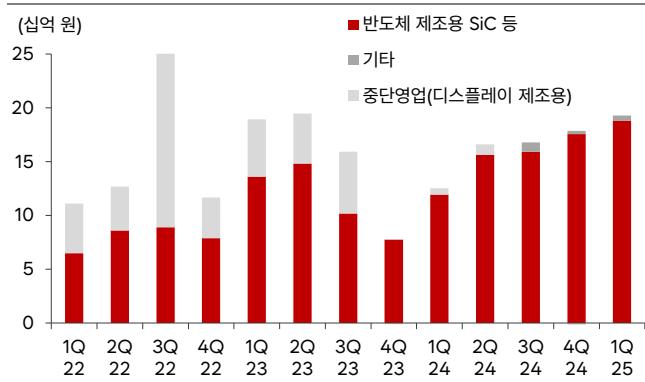
실적 추이 및 전망

1 고객사 원가절감 효과로 동사 부품 사용량 증가

2024년 매출액 622억 원(+31.4% YoY), 영업이익 141억 원(+35.1% YoY) 기록

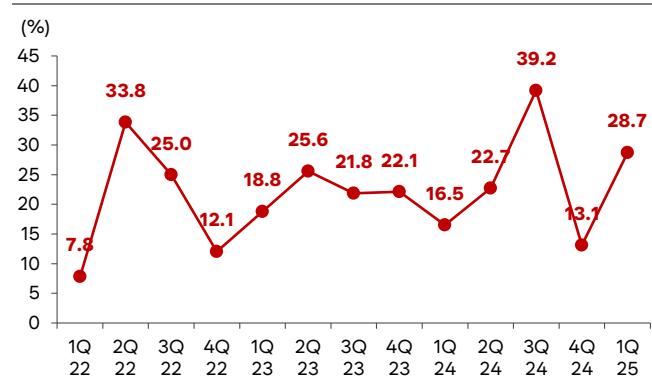
2024년 동사는 매출액 622억 원(+31.4% YoY), 영업이익 141억 원(+35.1% YoY)을 기록하였다. 2023년 동사의 파츠 매출액은 메모리 감산에도 불구하고 증가했다. 이는 Before Market 부품 업체들이 반도체 고객사의 재고 조정 영향을 받은 반면, 메모리 제조업체들이 감산 시 비용 절감을 위해 가격이 낮은 After Market 제품 사용을 확대했기 때문이다. 2024년에도 이와 같은 원가절감 기조가 이어지는 가운데 연중 AI 수요 강세에 따른 DRAM 가동률 개선이 이어졌다. 하반기 NAND 수요둔화로 인한 재감산의 영향이 일부 발생했음에도 상반기 매출액을 상회하는 하반기 실적을 기록하였다. 수익성 측면에서는 매출액 규모 확대로 전년 대비 소폭 개선된 영업이익률 22.7%를 기록하였다.

케이엔제이 부문별 실적 추이



자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

케이엔제이 분기별 영업이익률 추이



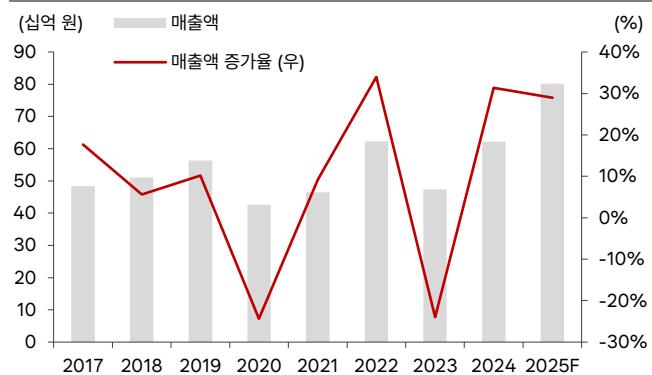
자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 After Market 확대로 실적 성장 기대

2025년 매출액 802억 원(+29.0% YoY), 영업이익 220억 원(+55.5% YoY) 전망

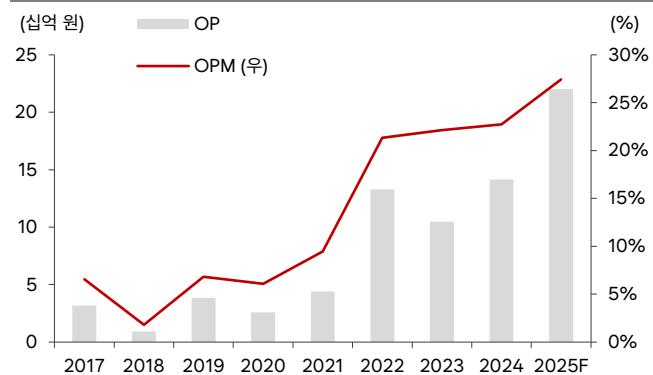
2025년 동사의 실적은 매출액 802억 원(+29.0% YoY), 영업이익 220억 원(+55.5% YoY)을 전망한다. 반도체 전반적으로 AI를 제외한 수요가 강하지 않은 상황이다. DRAM의 경우 HBM 수요 대응을 위한 선단 공정 투자가 지속되고 있으나, NAND는 감산을 통해 수급을 조절하고 있다. 특히 SiC Focus Ring은 NAND 공정에서 사용 비중이 높아, NAND 감산은 동사 부품 수요에 부정적으로 작용한다. 다만, 감산과 함께 진행되는 비용 절감 기조로 After Market 제품의 채택이 늘고 있는 점은 긍정적이다. 삼성전자는 SK하이닉스보다 After Market 제품 도입 시점이 늦어 현재 침투율이 낮은 것으로 파악되며, 향후 Warrant 기간 종료와 원가 절감 필요성에 따라 채택 비중이 확대될 여지가 있다. 최근 NAND 수급 개선에 따른 가격 반등세가 나타나고 있으며, 수요 회복이 이어질 경우 하반기 가동률 일부 회복과 부품 수요 증가가 가능할 것으로 보인다. 또한 NAND 고단화 전환 투자는 플라즈마 강도 증가로 이어져, 중장기적으로 SiC Focus Ring 수요 확대를 견인할 전망이다. 수익성 측면에서는 매출 증가와 제품 믹스 개선에 힘입어 영업이익률이 전년 대비 4.7%p 개선된 27.4%에 이를 것으로 예상된다.

케이엔제이 매출액 및 매출액 증가율 추이



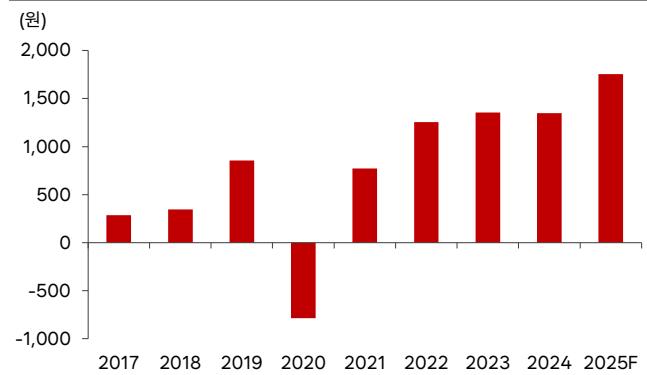
자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

케이엔제이 영업이익 및 영업이익률 추이



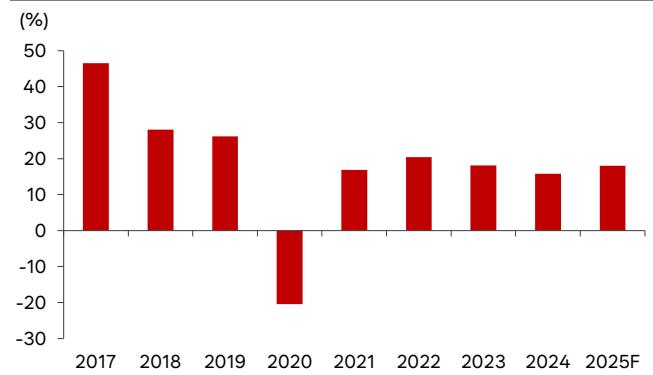
자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

케이엔제이 EPS 추이



자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

케이엔제이 ROE 추이



자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

케이엔제이 부문별 실적

(단위: 십억원)

	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2022	2023	2024	2025F
매출액	11.1	12.7	26.9	11.7	18.9	19.4	15.9	7.6	12.5	16.6	15.2	17.8	19.3	62.3	61.9	62.2	80.2
반도체 제조용 SiC 등	6.5	8.6	8.9	7.9	13.6	14.8	10.2	7.8	11.9	15.6	15.9	17.6	18.8	31.9	46.4	61.0	79.0
기타	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	0.5	0.0	0.0	1.2	1.2
중단영업	4.6	4.1	18.0	3.8	5.3	4.6	5.8	-0.1	0.6	1.0	-1.6	-	-	30.4	15.5	-	-
영업이익	0.9	4.3	6.7	1.4	3.6	5.0	3.5	-1.5	2.1	3.8	6.0	2.3	5.5	13.3	10.5	14.1	22.0
지배주주순이익	0.6	4.5	7.5	-2.6	3.5	5.1	3.6	-14	3.1	3.8	2.5	1.4	4.6	10.0	10.8	10.8	14.1
Margin(%)																	
영업이익률	7.8	33.8	25.0	12.1	18.8	25.6	21.8	22.1	16.5	22.7	39.2	13.1	28.7	21.3	22.1	22.7	27.4
지배주주순이익률	5.8	35.2	27.8	-22.5	18.6	26.2	22.6	20.9	24.6	22.6	16.7	7.8	23.6	16.0	22.7	17.3	17.5
YoYGrowth(%)																	
매출액	25.9	-0.4	94.2	4.8	70.3	53.3	-40.7	적전	-33.7	-14.5	-4.4	흑전	53.9	34.0	-24.0	31.4	29.0
반도체 제조용 SiC 등	50.9	37.3	43.7	23.1	109.9	72.2	14.3	-1.6	-12.3	5.4	56.3	126.5	57.6	37.6	45.4	31.6	29.5
영업이익	흑전	224.9	122.2	150.0	307.7	15.9	-48.2	적전	-41.7	-24.1	71.4	흑전	167.3	202.5	-21.2	35.1	55.5
지배주주순이익	-57.0	흑전	88.6	적전	441.1	14.2	-51.7	적지	-12.2	-26.4	-29.5	흑전	48.1	80.2	8.1	0.1	30.7
QoQGrowth(%)																	
매출액	-0.2	14.3	111.8	-56.6	62.2	2.8	-18.1	적전	흑전	32.6	-8.4	17.2	8.1				
반도체 제조용 SiC 등	1.3	32.8	3.4	-11.6	72.7	9.0	-31.4	-23.9	54.0	31.0	1.8	10.3	7.2				
영업이익	55.1	393.0	56.4	-79.1	152.9	40.1	-30.1	적전	흑전	82.2	57.9	-60.8	137.0				
지배주주순이익	82.7	588.9	67.1	적전	흑전	45.4	-29.4	적전	흑전	22.0	-32.4	-44.9	225.9				

주: 디스플레이 제조용 장비 사업은 2024년 9월 종단되었으며, 해당 사항은 2023년 실적에 소급 적용하지 않음

자료: Quantwise, 한국IR협의회 기업리서치센터



Valuation

2025F PER 10.7x

2025F PER 10.7x로 PER Band

중하단에 위치. NAND 수요

회복과 고객사 가동률 개선에 따른

밸류 확대 기대하며, 신규 CAPA

증설을 통한 수요 대응력도 주목할

필요

동사의 현 주가는 2025F PER 10.7배로, Historical PER Band(8.8x~19.0x) 중하단에 위치한다. 동사 Peer로는 반도체 소모성 부품 업체들을 선정하였으며 Peer의 2025F 평균 PER은 14.7x 수준이다. 동사와 가장 유사한 업체인 티씨케이의 2025F PER은 17.2x 수준으로 동사 대비 약 50% 이상 할증 받고 있다. 티씨케이는 Before Market에서 약 60%의 점유율을 확보한 사실상 독점 공급사로, 매출 규모는 동사 대비 약 4배, 영업이익률은 30% 내외에 달한다. 이러한 실적 규모·수익성·시장 지배력 차이가 높은 밸류에이션을 받는 주요 요인으로 판단된다.

동사는 2023년 SiC Focus Ring CAPA 증설에 따른 성장 기대감으로 Valuation 상단을 기록했으나, 2024년 하반기의 국내 주식 시장 약세에 따라 Valuation 하단 수준까지 하락하였다. 다만 반도체 After Market(AM) 시장 확대와 2024년 9월 디스플레이 장비 사업 중단에 따른 수익성 개선 기대가 반영되며 2025년 들어 주가가 점진적으로 회복되고 있다. 그럼에도 불구하고 주요 고객사의 NAND 가동률이 여전히 낮아 밸류에이션 확장은 제한적인 상황이다. 향후 NAND 수요 회복과 고객사 가동률 개선이 이뤄질 경우 실적 성장 모멘텀 강화와 함께 밸류에이션 확대가 가능할 것으로 보인다. 또한 신규 CAPA 확장을 통한 수요 대응력 제고도 주목할 만하다.

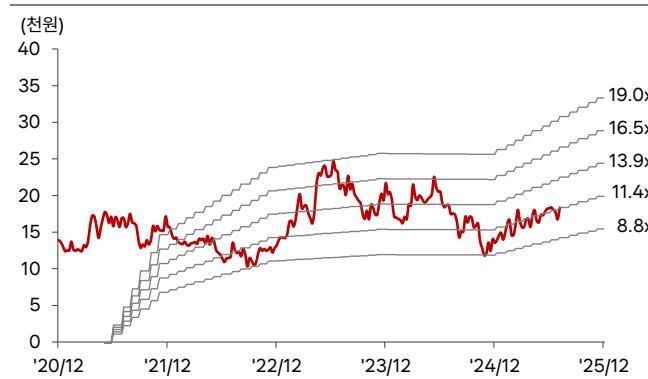
동종 업종 밸류에이션

기업명	종가 (원)	시가총액 (십억원)	매출액(십억원)			PER(배)			PBR(배)		
			2023	2024	2025F	2023	2024	2025F	2023	2024	2025F
코스피	3,224	2,580,658	3,517,716	3,753,881	3,020,591	-	-	12.0	-	-	1.1
코스닥	814	424,709	330,041	334,267	113,051	-	-	28.8	-	-	2.7
케이엔제이	18,820	151	47	62	80	14.3	10.0	10.7	2.4	1.5	1.8
티씨케이	115,200	1,345	227	276	315	21.2	11.5	17.2	2.8	1.6	2.3
원익QnC	18,360	483	806	892	950	19.8	9.2	10.8	1.9	1.0	0.9
하나미터리얼즈	26,350	521	234	252	255	29.0	14.3	16.1	2.5	1.3	1.3
월데스	24,100	398	288	307	-	7.9	4.3	-	1.8	0.9	-
동종업종 평균						19.5	9.8	14.7	2.2	1.2	1.5

주: 2025년 8월 13일 종가 기준. 동종그룹 25F는 시장 컨센서스 사용

자료: Quantwise, 한국IR협의회 기업리서치센터

케이엔제이 PER Band



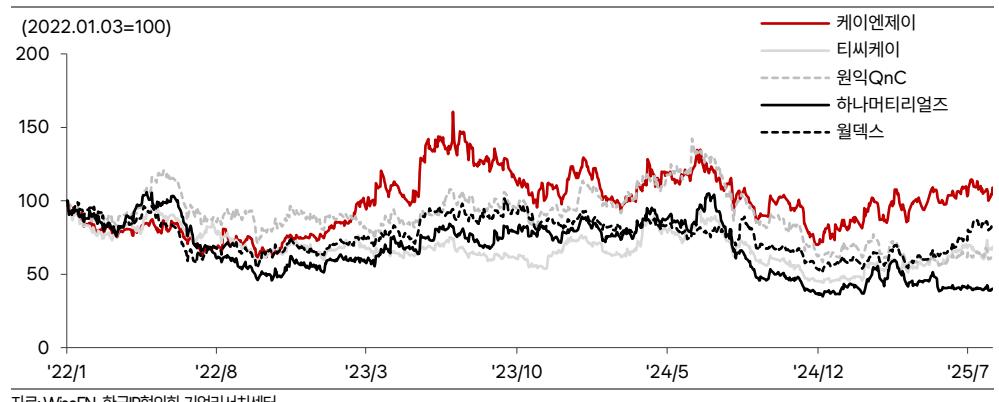
자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

케이엔제이 PBR Band



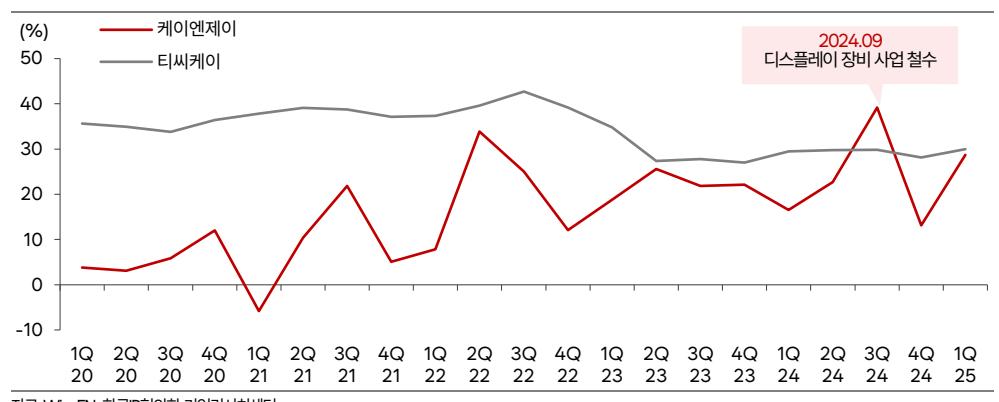
자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

반도체 패치 업체 상대 주가 추이



자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

SiC 공급 업체 OPM 추이



자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터



1 국내 편중된 매출 비중

매출의 90%가 국내 고객사향으로 편중된 점은 리스크 요인이나, 신규 CAPA 증설을 통해 국내 애프터 마켓 수요 대응하고, 향후 중국 메모리업체향 공급도 검토 중

국내에 편중된 매출 비중은 동사의 리스크 요소라 판단된다. 동사의 경쟁사라고 할 수 있는 티씨케이의 경우 식각 장비사인 Lam Research, Applied Materials, Tokyo Electron 등 글로벌 식각 장비사를 통해 제품을 공급하며, 국내 삼성전자-SK하이닉스를 포함한 전 세계 반도체 업체에 SiC Focus Ring을 납품하고 있다. 반면 동사는 국내 반도체 업체에 직접 납품하는 구조로, 매출의 90% 이상이 국내 고객사에서 발생한다. 이는 After Market 확대가 본격화된 지 오래 되지 않았고, 동사의 생산 규모가 해외 고객사까지 대응하기 어려웠기 때문이다. 이로 인해 동사는 티씨케이에 비해 국내 반도체 업체의 신규 CAPA 투자와 가동률 변화에 실적이 더 민감하게 영향을 받는다. 다만 국내 After Market 확대 여지가 여전히 크기 때문에, 동사는 신규 CAPA 증설을 통해 국내 수요에 우선 대응하고 있으며, 향후 중국 메모리업체로의 공급도 검토하고 있다. 고객사 다변화는 중장기 과제로 접근할 필요가 있다.

포괄손익계산서

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025F
매출액	465	623	474	622	802
증가율(%)	9.2	34.0	-24.0	31.4	29.0
매출원가	335	384	320	401	500
매출원가율(%)	72.0	61.6	67.5	64.5	62.3
매출총이익	130	239	154	222	302
매출이익률(%)	27.9	38.3	32.5	35.6	37.7
판매관리비	86	106	49	80	83
판관비율(%)	18.5	17.0	10.3	12.9	10.3
EBITDA	65	166	153	195	318
EBITDA 이익률(%)	14.0	26.7	32.2	31.4	39.6
증가율(%)	37.2	154.9	-8.2	28.0	62.8
영업이익	44	133	105	141	220
영업이익률(%)	9.4	21.3	22.1	22.7	27.4
증가율(%)	69.2	202.5	-21.2	35.1	55.5
영업외손익	27	-1	-7	16	-1
금융수익	26	20	29	30	22
금융비용	12	32	42	31	31
기타영업외손익	13	11	6	16	8
총속/관계기업관련손익	-19	-11	-6	8	8
세전계속사업이익	52	121	91	166	227
증가율(%)	흑전	131.4	-5.2	2.3	48.6
법인세비용	-3	21	7	9	33
계속사업이익	55	100	85	151	184
중단사업이익	0	0	23	-49	-53
당기순이익	55	100	108	108	141
당기순이익률(%)	11.9	16.0	22.7	17.3	17.5
증가율(%)	흑전	80.2	8.1	0.1	30.7
자배주주지분 순이익	55	100	108	108	141

재무상태표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025F
유동자산	273	368	516	573	644
현금성자산	86	128	178	156	200
단기투자자산	32	26	28	17	17
매출채권	54	51	55	76	83
재고자산	93	157	244	306	321
기타유동자산	8	6	11	18	23
비유동자산	664	713	748	995	1,131
유형자산	467	531	538	615	717
무형자산	24	24	28	28	28
투자자산	57	50	85	274	308
기타비유동자산	116	108	97	78	78
자산총계	937	1,081	1,264	1,568	1,775
유동부채	165	211	295	468	523
단기차입금	105	117	160	234	234
매입채무	22	17	18	23	26
기타유동부채	38	77	117	211	263
비유동부채	335	332	317	388	399
사채	30	0	0	0	0
장기차입금	274	298	275	347	347
기타비유동부채	31	34	42	41	52
부채총계	500	543	613	856	923
지배주주지분	437	538	651	711	852
자본금	40	40	40	40	40
자본잉여금	372	374	374	382	382
자본조정 등	-6	-6	-2	-33	-33
기타포괄이익누계액	0	-1	5	-12	-12
이익잉여금	31	131	234	334	475
자본총계	437	538	651	711	852

현금흐름표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025F
영업활동으로인한현금흐름	116	106	128	176	267
당기순이익	55	100	108	108	141
유형자산 상각비	21	33	48	54	98
무형자산 상각비	0	0	0	0	0
외환손익	2	20	7	4	0
운전자본의감소(증가)	23	-96	-47	-9	39
기타	15	49	12	19	-11
투자활동으로인한현금흐름	-268	-93	-83	-319	-222
투자자산의 감소(증가)	0	3	-26	-196	-26
유형자산의 감소	0	0	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-258	-94	-53	-123	-200
기타	-10	-2	-4	0	4
재무활동으로인한현금흐름	155	38	0	117	0
차입금의 증가(감소)	159	42	35	148	0
사채의증가(감소)	0	0	-30	0	0
자본의 증가	0	0	0	0	0
배당금	0	0	0	0	0
기타	-4	-4	-5	-31	0
기타현금흐름	2	-9	5	4	-1
현금의증가(감소)	4	42	50	-22	44
기초현금	82	86	128	178	156
기말현금	86	128	178	156	200

주요투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025F
P/E(배)	22.2	10.2	14.3	10.0	10.7
P/B(배)	3.1	1.9	2.4	1.5	1.8
P/S(배)	2.6	1.6	3.2	1.7	1.9
EV/EBITDA(배)	25.5	8.0	11.8	7.8	6.0
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPS(원)	771	1,255	1,354	1,349	1,755
BPS(원)	5,518	6,769	8,182	8,887	10,619
SPS(원)	6,492	7,854	5,960	7,790	9,998
DPS(원)	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROE	16.8	20.4	18.1	15.8	18.0
ROA	6.6	9.9	9.2	7.6	8.4
ROIC	9.2	18.4	12.4	14.9	19.8
안정성(%)					
유동비율	165.6	173.8	174.6	122.3	123.0
부채비율	114.3	101.0	94.1	120.4	108.3
순차입금비율	69.3	57.5	40.4	62.3	46.8
이자보상배율	6.9	9.9	4.9	5.9	8.1
활동성(%)					
총자산회전율	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5
매출채권회전율	7.5	12.0	9.0	9.5	10.1
재고자산회전율	4.7	5.0	2.4	2.3	2.6

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
케이엔제이	X	X	X

발간 History

발간일	제목
2025.08.18	케이엔제이-SIC Ring 애프터마켓 성장
2022.08.12	케이엔제이-SIC 포커스링 성장은 이제 시작

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간접 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성을 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 저작재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(https://t.me/kirsofficial)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '小中한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '小中한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.